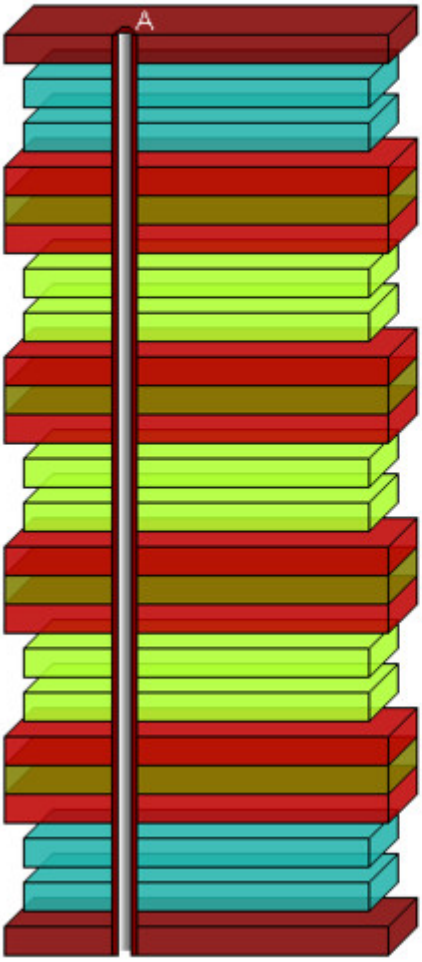
Multilayer 10 Lagen - 3,2 mm

Lagenaufbau

Ebene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
		Cu+galv.Cu		18+25	
1		Prepreg	0.068		1080
		Prepreg	0.068		1080
		Cu		35	
2		Tr-Lam	0.36		
		Cu		35	
3		Prepreg	0.178		7628
		Prepreg	0.178		7628
		Cu		35	
4		Tr-Lam	0.36		
		Cu		35	
5		Prepreg	0.178		7628
		Prepreg	0.178		7628
		Cu-Lam		35	
6		Tr-Lam	0.36		
		Cu		35	
7		Prepreg	0.178		7628
		Prepreg	0.178		7628
		Cu		35	
8		Tr-Lam	0.36		
		Cu		35	
9		Prepreg	0.068		1080
		Prepreg	0.068		1080
		Cu+galv.Cu		18+25	
10					

Presslingsdicke *	3,07	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske *	3,18	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com

Multilayer 10 Lagen - 3,2 mm

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 400 µm
	Viapad-Ø	≥ 700 µm
Leiterbild Außenlagen		
	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 190 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 240 µm
Leiterbild Innenlagen		
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥85 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 100 µm

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com